

Sección _____

MT Semiconductora

Función _____

Terreno
Producción



Plus producto

4 profundidades de incisión
Desprendimiento de la
semiconductora fácil
Ligero

Capacidad

Diámetro 10 - 100 mm

Profundidad de incisión 0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1 mm

Largo restante de semiconductor 10 mm / cubierta - 4mm / pantalla

Características

Largo	135 mm
Ancho	55 mm
Alto	35 mm
Peso fuera de la caja	0,16 Kg
Embalaje	Cartón

Herramienta para la incisión longitudinal de la semiconductora pelable

UTILIZACIÓN

L'ORACL permite hacer una incisión longitudinal de la semiconductora vulcanizada para después retirarse a la mano.

Profundidades de incisión regulable (0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1 mm).



Piezas de recambio

LSO - Navaja por el marcado de la semiconductora

Herramientas complementarias

DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable

MVS - Tope de parada de herramientas

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE

FRANCE

Teléfono: +33 2 43 71 11 80

Fax: +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Herramientas para cables MT

ORACL



Referencia	Diámetro	Capacidad		Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de incisión	Largo restante de semiconductor	Largo	Ancho	Alto	
ORACL	10 - 100 mm	0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1 mm	10 mm / cubierta - 4mm / pantalla	135 mm	55 mm	35 mm	cartón